

## Micro-Timer I Kontakte

## Technische Daten

## Kontaktmaterial:

CuSn4, CuFe2,  
Überfeder aus rostfreiem Stahl

## Kontaktoberfläche:

vorverzinkt, vorversilbert,  
selektiv vergoldet

## Leiterquerschnittsbereich:

0,35–1,0 mm<sup>2</sup> (FLKr)

Kontakt-Übergangswiderstand  
(Neuzustand):

CuSn4: < 5 mΩ  
CuFe2: < 4 mΩ

## Max. Gesamttemperatur:

–40 °C bis 120 °C (verzinkt)  
–40 °C bis 140 °C (vergoldet)

## Anzahl der Steckzyklen:

20 (verzinkt)  
100 (vergoldet)

## Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. 726510

## Steckkraft:

max. 5 N (Messung mit Prüfflach-  
stecker 0,8 mm dick)

## Ziehkraft:

min. 2 N (Messung mit Prüfflach-  
stecker 0,8 mm dick)

## Ausreißkraft:

– aus Gehäuse ohne 2. Kontakt-  
sicherung min. 20 N  
– aus Gehäuse nur 2. Kontakt-  
sicherung min. 40 N

## Abmessungen

## des Kontaktmessers:

1,6 mm x 0,8 mm

## Rastermaße

## Einteiliges Gehäuse:

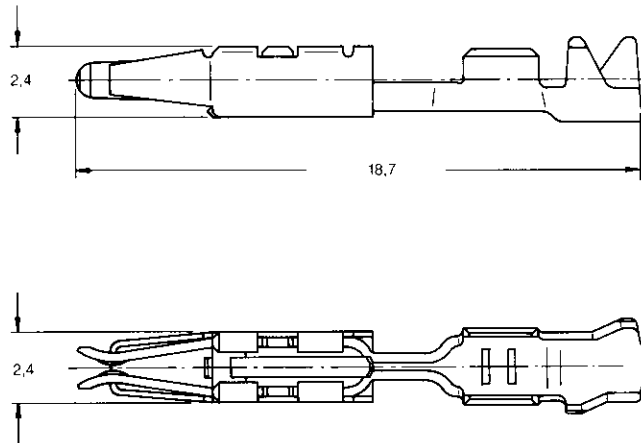
0,75 mm<sup>2</sup> = min. 3,0 x 3,0 mm

## Zweiteiliges Gehäuse:

0,75 mm<sup>2</sup> = min. 3,0 x 3,7 mm

## Produkt-Spezifikation:

108-18024

Max. Strom:  
im 9poligen GehäuseMax. Current:  
in 9 Positions Housing

Material Material	Temperatur Temperature (°C)	Strombelastbarkeit/Current Rating A		
		0,35 mm <sup>2</sup>	0,50 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>
CuSn4	20	3,0	5,0	8,0
CuSn4	90	1,5	2,0	4,0
CuFe2	20	4,0	6,0	10,0
CuFe2	90	1,5	2,5	5,0

## Micro-Timer I Contacts

## Technical Features

## Contact Material:

CuSn4, CuFe2,  
cantilever spring stainless steel

## Contact Finish:

pre-tin plated, pre-silver plated,  
selective gold plated

## Wire Size Range:

0.35–1.0 mm<sup>2</sup> (FLKr)

## Contact Resistance

## (New State):

CuSn4: < 5 mΩ  
CuFe2: < 4 mΩ

## Total Temperature max.:

–40 °C to 120 °C (tin plated)  
–40 °C to 140 °C (gold plated)

## Mating Cycles:

20 (tin plated)  
100 (gold plated)

## Extraction Tool:

Part No. 726510

## Insertion Force:

max. 5 N  
(proof tab 0.8 mm thick)

## Extraction Force:

min. 2 N  
(proof tab 0.8 mm thick)

## Retention Force:

– from housings without second  
locking device min. 20 N  
– from housings only second  
locking device min. 40 N

## Dimensions

## of Male Contacts:

1.6 mm x 0.8 mm

## Modular Dimensions

## Single Housings:

0.75 mm<sup>2</sup> = min. 3.0 x 3.0 mm

## Double Housings:

0.75 mm<sup>2</sup> = min. 3.0 x 3.7 mm

## Product Specification:

108-18024

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,20–0,50	–	1,2–1,6	-1/-2/-3/-4	929950	929951	878467-2	734290-0
0,50–1,00	–	1,4–2,1	-1/-2/-3/-4/-7/-8	929952	929953	878468-2	734290-0
1,00–1,50	–	1,9–2,4	-1/-2/-3/-4	929954	929955	878469-2	734290-0
0,35–0,75	–	1,2–1,9	-1/-2/-3/-4	928939	929927	878376-2	734290-0

## \* Material und Oberfläche:

-1 = CuSn4, vorverzinkt  
-2 = CuSn4, selektiv 0,8 μm Au über 1,3 μm Ni/galv. Sn, 2–5 μm  
-3 = CuFe2, vorverzinkt  
-4 = selektiv 0,8 μm Au über 1,3 μm Ni/galv. Sn, 2–5 μm  
-7 = CuSn4, galv. 0,8 μm Au, selektiv 0,8 μm Au über 1,3 μm Ni,  
Rest galv. 2–5 μm Sn = Kurzschlußausführung  
-8 = CuFe2, galv. 0,8 μm Au, selektiv 0,8 μm Au über 1,3 μm Ni,  
Rest galv. 2–5 μm Sn = Kurzschlußausführung

## \* Material and Finish:

-1 = CuSn4, pre-tin plated  
-2 = CuSn4, selective 0.8 μm gold over 1.3 μm nickel/galv. tin, 2–5 μm  
-3 = CuFe2, pre-tin plated  
-4 = selective 0.8 μm gold over 1.3 μm nickel/galv. tin, 2–5 μm  
-7 = CuSn4, galv. 0.8 μm gold, selective 0.8 μm gold over 1.3 μm nickel,  
galv. 2–5 μm tin = short circuit version  
-8 = CuFe2, galv. 0.8 μm gold, selective 0.8 μm gold over 1.3 μm nickel,  
galv. 2–5 μm tin = short circuit version